

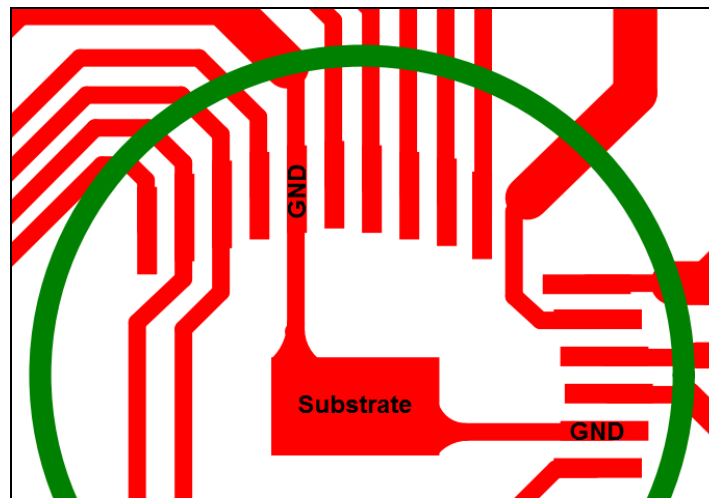
## 語音 IC 的 PCB Layout 注意事項

**內容：** 說明語音 IC 在播放過程中會產生高熱，如果 COB 散熱不良，有機會超過工作溫度範圍，請客戶留意 PCB layout 的設計。

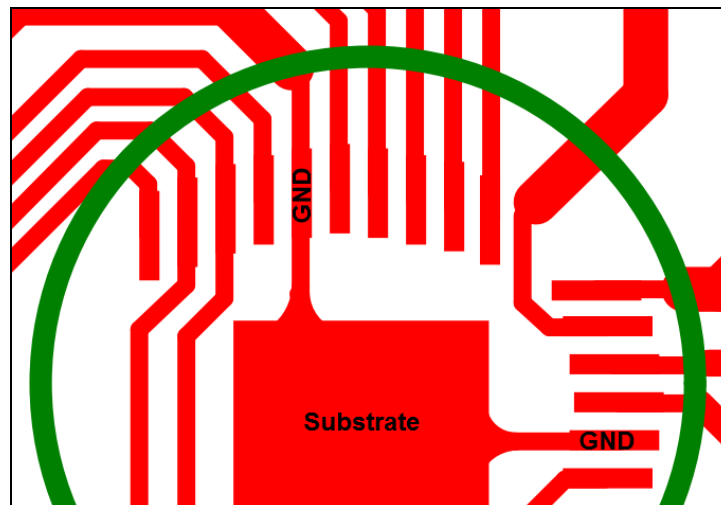
**原因：** 當 IC 播放聲音時，會產生高熱，電壓越高或喇叭歐姆數越低，溫度越高，而 PCB 設計不良會導致散熱困難，有機會超過工作溫度範圍。另外，若在未封膠的環境下播放聲音，少了黑膠幫助散熱，更會使溫度快速提升。

**方法：**

1. Layout 時，將 COB 的 substrate 與 GND 連接，增加散熱面積。



2. Layout 時，將 COB 的 substrate 加大，增加散熱面積。



3. COB 封膠幫助散熱。